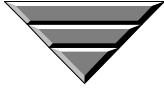


NEW



PCI Express対応基板対基板コネクタ

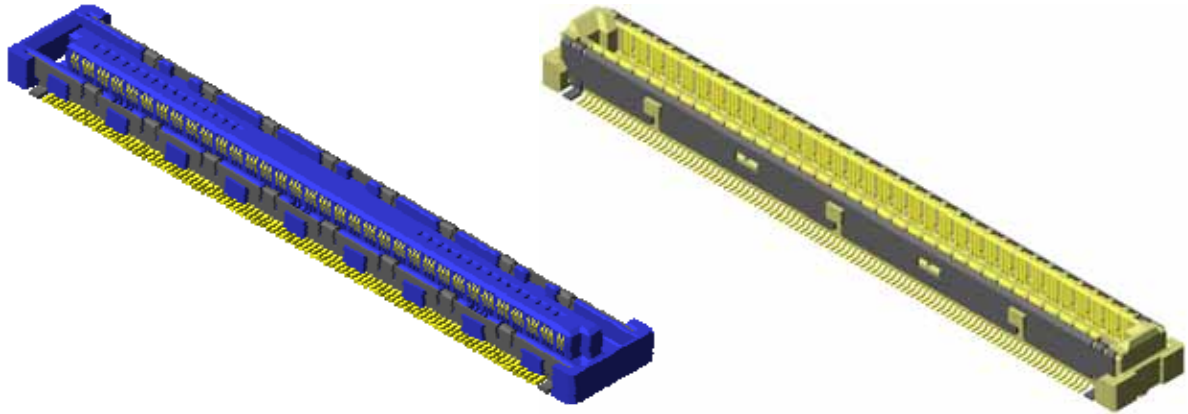
WB3シリーズ

CONNECTOR

MB-0138-2

2006/7

R o H S 対応品



WB3シリーズは、PCI Expressスタンダードで定められた伝送特性SPECを満足した基板対基板接続用のコネクタであり、グラフィックスカードをはじめ、PCI Express、TMDSの伝送が必要なエッジ間接続に最適です。

特 長

PCI Express Card Electrical Mechanical SPECに準拠しています。
0.5mmピッチと高密度でありながら、レベルの高い伝送特性を有しており、高速伝送が可能です。
PCI Express(X16)をはじめ、TMDS、VGA信号等の伝送が可能な芯数構成になっています。
基板対基板平行接続が可能です。スタック高さは4mmと5mmを開発しました。
EMIシールドリングが施されています。
自動実装が可能です。梱包形態はインボーステープです。

一 般 仕 様

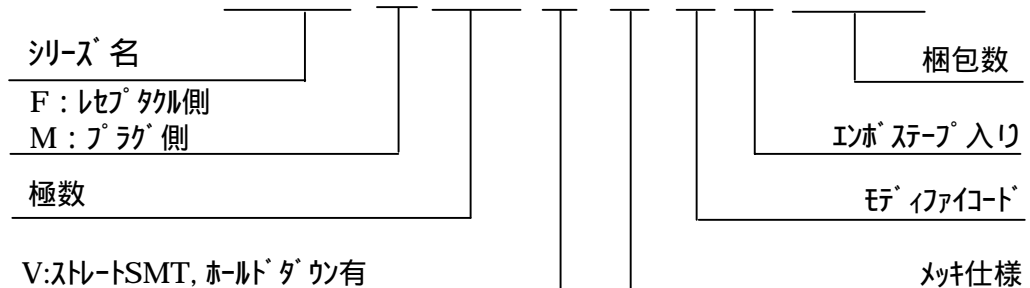
極数 : 200極
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 耐電圧 : AC 250Vrms 1分間
 使用温度 : -40 ~ 85
 定格電流 : 0.5A/1本あたり
 寿命 : 25回
 インサクションロス : -1dB以上(1.25Ghz以下)/-5dB以上(3.75Ghz以下)
 リターンロス : -12dB以下(1.3Ghz以下)/-7dB以下(2Ghz以下)/-4dB(3.75Ghz以下)
 コストーク(近端) : -32dB以下(1.25Ghz以下)/-26 dB以下(3.75Ghz以下)

材料 ・ 仕上

構成部品	材料 / 仕上
レセ [°] タクル	
コ ^ン タ ^ク ト	銅合金 / 接触部 : Ni 上 Au 0.76 μ m以上 端子部 : Ni 上 Auフラッシュ
インシュレ [°] タ	熱可塑性樹脂 UL94V-0 黒
シ ^ェ ル	銅合金 : ス ^ス メ ^キ
プ ^ラ グ	
コ ^ン タ ^ク ト	銅合金/接触部 : Ni 上 Au 0.76 μ m以上 端子部 : Ni 上 Auフラッシュ
インシュレ [°] タ	熱可塑性樹脂 UL94V-0 黒
シ ^ェ ル	ステン ^ス : ス ^ス メ ^キ

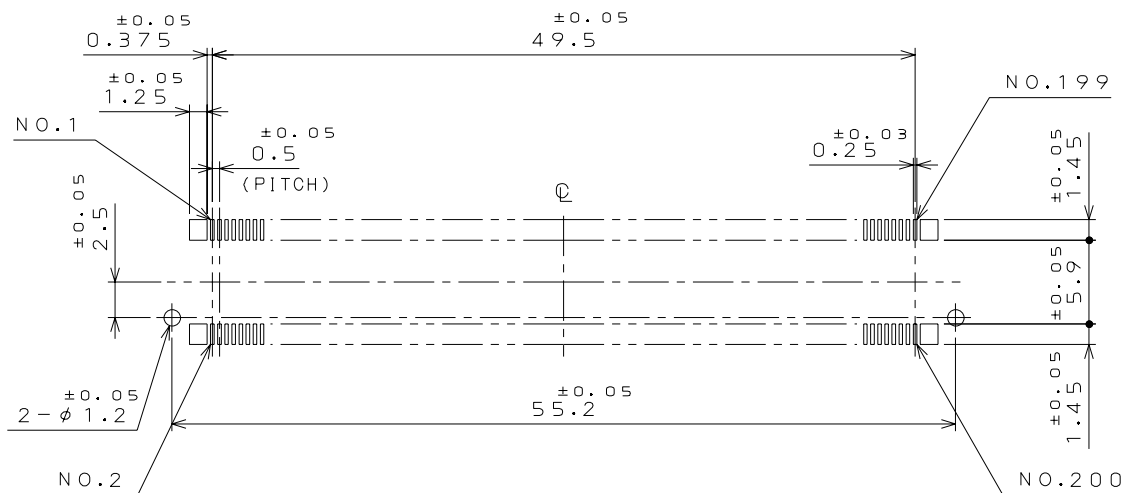
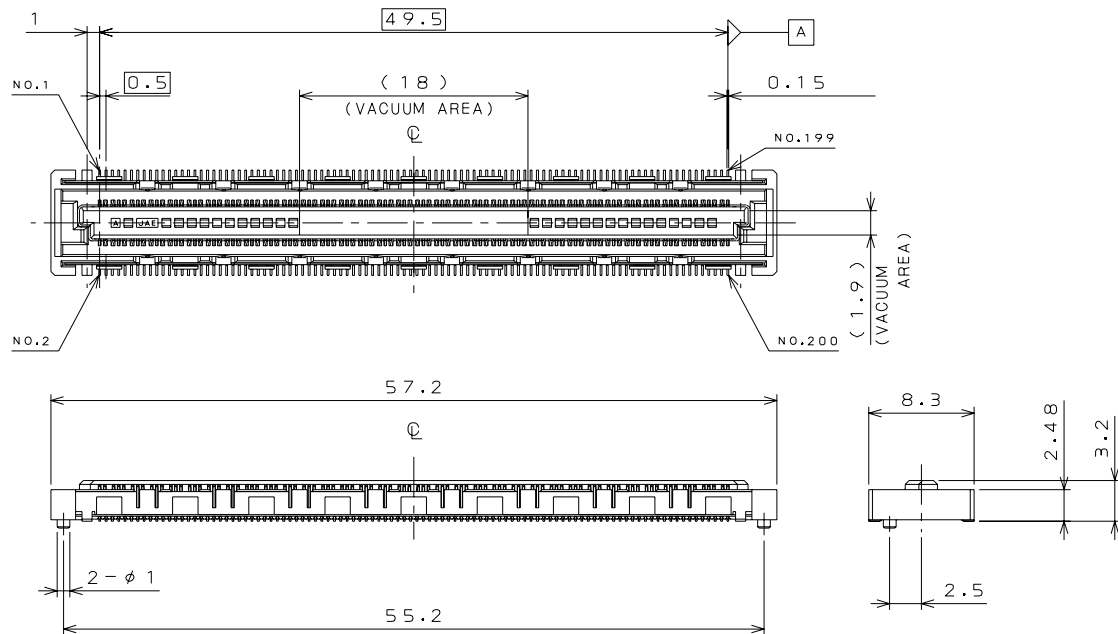
品名構成

WB3 F 200 V D 1 R 1000



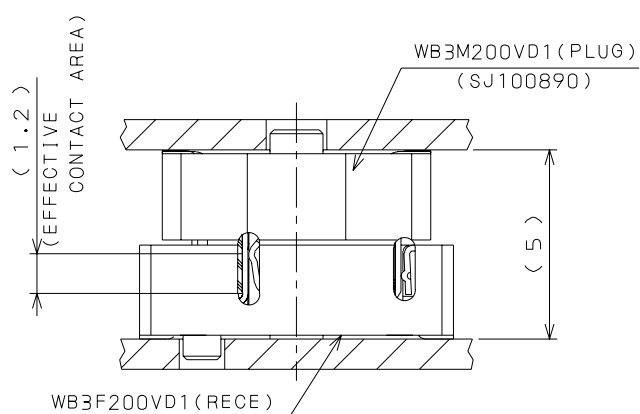
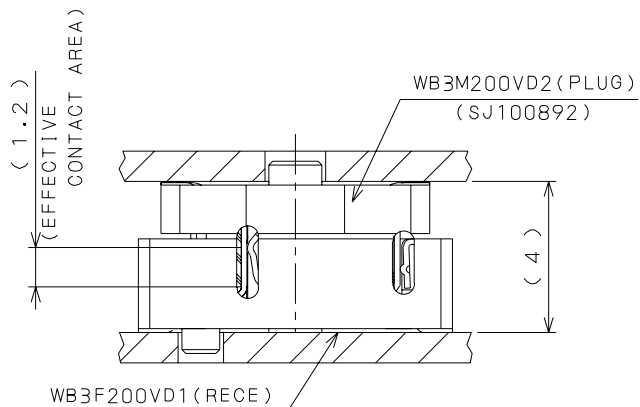
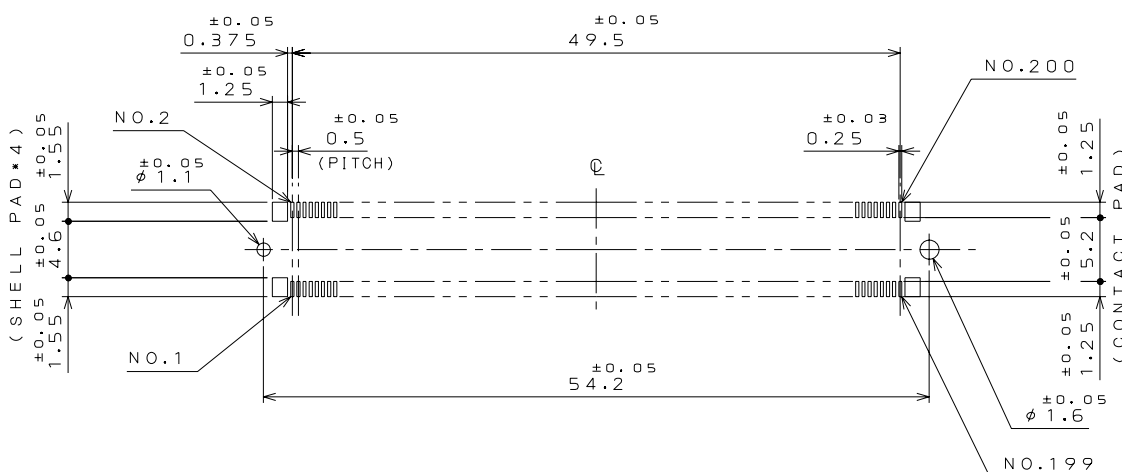
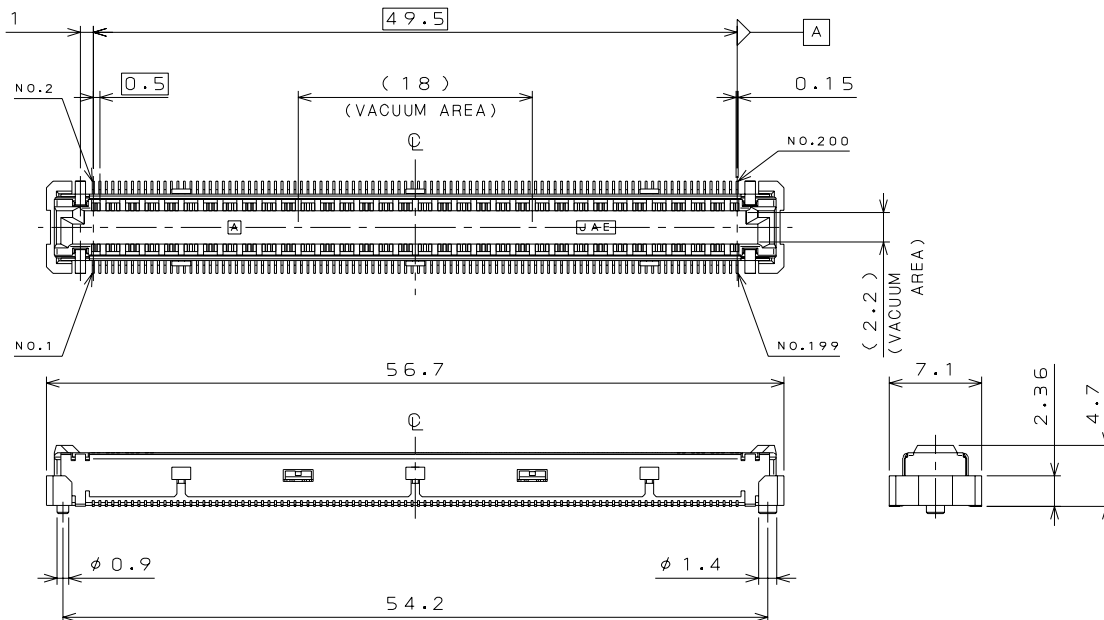
レフ^oタル側:WB3F200VD1 (SJ100888)

インボス梱包品 :WB3F200VD1R1000 (SJ100889)



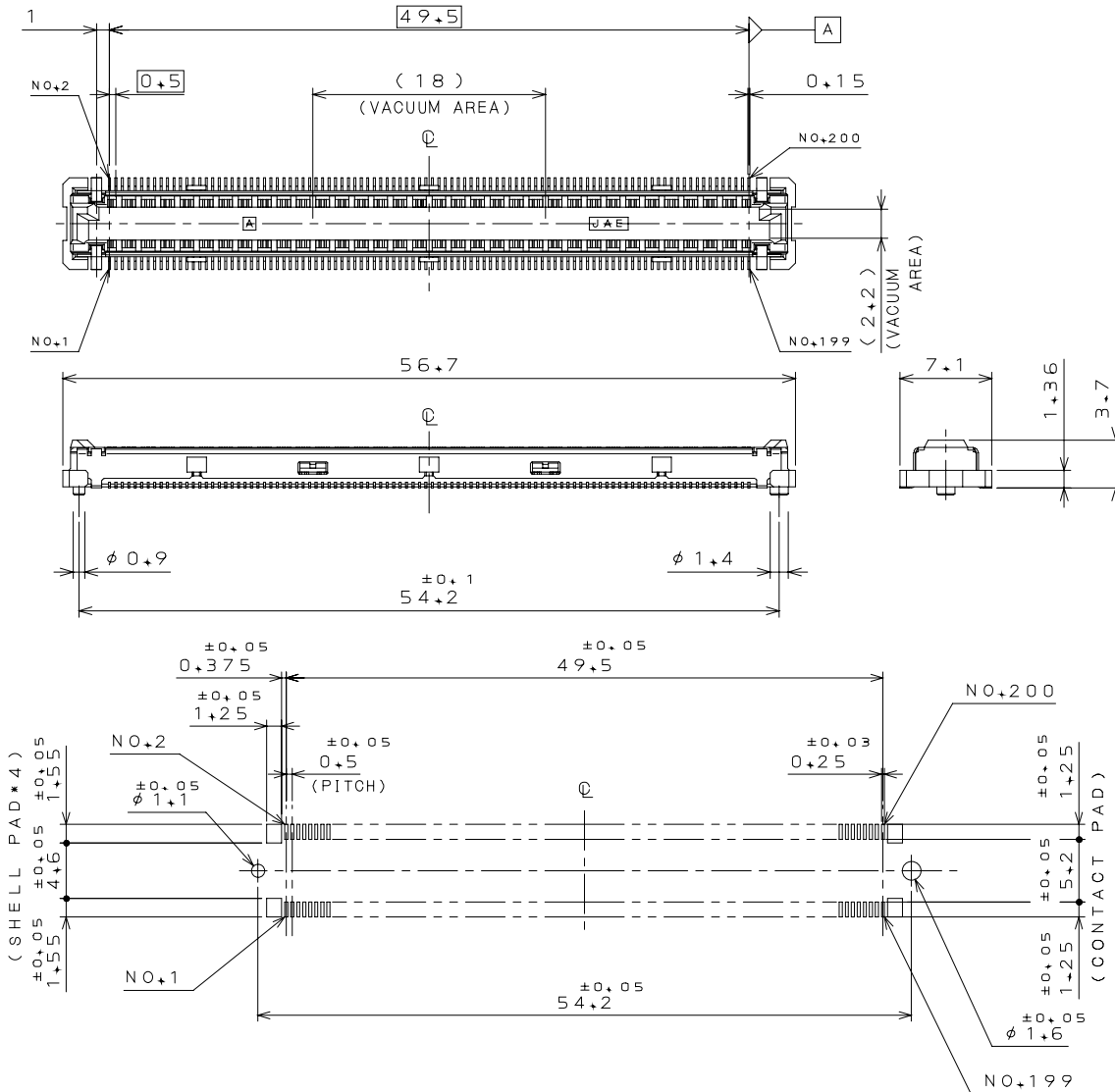
プラグ側:WB3M200VD1 (SJ100890)

イボス梱包品 :WB3M200VD1R800 (SJ100891)



プロダクト側 :WB3M200VD2
 エンボス梱包品 :WB3M200VD2R1000

(SJ100892)
 (SJ100893)



ご注文に際してのお願い

本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従い、推奨用途以外へのご使用又は「航空宇宙機器」、「海底中継器」、「原子力制御システム」、「生命維持のための医療機器」などの極めて高信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に当社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます。

推奨用途例 : 電算機、事務機、計測機器、通信機器(端末、移動体)、AV機器、家電、FA機器、等。



プロダクトマーケティング本部
 〒153-8539 東京都目黒区青葉台 3-1-19 (青葉台ビル)
 TEL : 03-3780-2787 FAX : 03-3780-2946

改良の為、予告なく形状・仕様等変更することが有ります。ご検討の際はお問合せ下さい。